

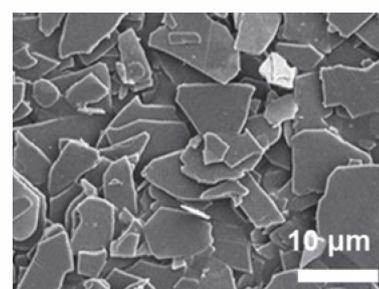
特殊形状フィラー『CeramNex (セラネクス)』

板状アルミナ

特徴

厚さと粒径がそろったマイクロサイズの板状粒子
独自合成技術により量産に成功

物性(代表値)	単位	AP05	AP10	AP20
粒径 (d50)	μm	4	8	13
厚み	μm	0.1	0.5	0.5
アスペクト比	-	30	15	28
比表面積	m ² /g	6.5	1.7	1.5
高密度	g/mL	0.15	0.3	0.3
開発状況	-	開発中	発売中	開発中

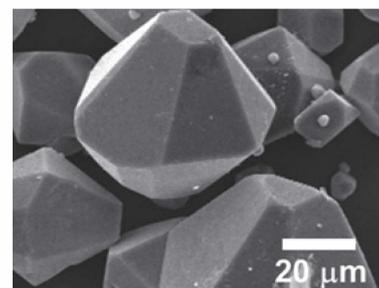


多面体アルミナ

特徴

従来にはない25μm以上の大粒径、14面体構造
粒子同士の面接触が可能、効率的に熱伝導パスを形成

物性(代表値)	単位	AH30-S	AH40-S
粒径 (d50)	μm	28	32
比表面積	m ² /g	0.15	<0.1
高密度	g/mL	1.7	1.7
開発状況	-	開発中	開発中

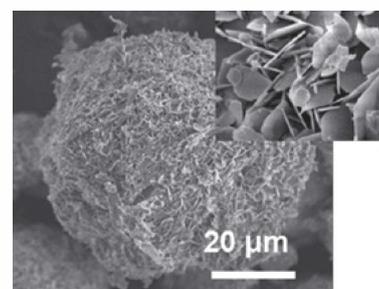


カードハウスアルミナ

特徴

板状アルミナが相互に結合し、内部に空隙を有する
合成段階で結合させることで高い圧壊強度を示す

物性(代表値)	単位	AC75
粒径 (d50)	μm	70
比表面積	m ² /g	1.4
高密度	g/mL	0.7
圧壊強度	MPa	40
開発状況	-	開発中



※ 本カタログ記載の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。

特殊形状フィラー『CeramNex (セラネクス)』

用途例

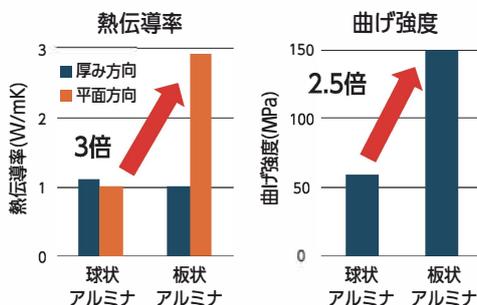


事例

① 高熱伝導性・② 補強性 (熱伝導性コンパウンド)

板状アルミナ添加効果

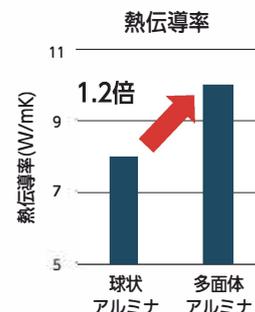
- ・平面方向熱伝導率向上
- ・機械強度向上
- ・球状フィラー併用で厚み方向熱伝導向上



① 高熱伝導性 (シート)

多面体アルミナ添加効果

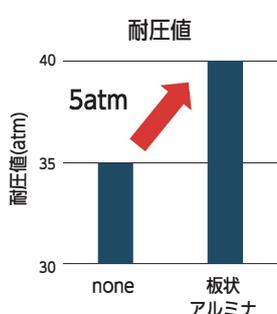
- ・フィラー面接触による太い熱伝導パス形成
- ・高熱伝導



② 補強性 (チューブ)

板状アルミナ添加効果

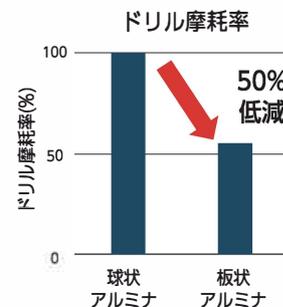
- ・機械強度向上
- ・耐圧性向上
- ・薄肉化
- ・バリア性向上



③ 摩耗性 (電子回路基板)

板状アルミナ添加効果

- ・摩耗性低減
- ・ドリル加工性向上
- ・耐摩耗性向上
- ・摩擦性



※ 本カタログ記載の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。